

ヤハタ精工 株式会社

当社の
会社概要
or
得意技

プリント基板の微細穴あけ加工技術

概要

プリント基板の微細穴あけ加工をドリル、レーザーで試作から量産までサポートします ABF樹脂からFR5相当まで

- ビルドアップ配線板のブラインド加工(φ 0.05からφ 0.2)
- Cuダイレクト加工によるブラインド加工
- 両面基板のブラインド加工(φ 0.05からφ 0.2)
- 太径・キャビティー加工(両面板・多層板)
- ドリルによりφ 0.1の穴あけ加工より



企業概況

会社名	ヤハタ精工株式会社	代表者名	北原 良輔
		窓口担当	北原 良輔
事業内容	プリント配線基板加工、電子部品加工	U R L	http://www.yahata-seiko.co.jp
主要製品	プリント基板、プリント回路基板、電子デバイス部品、他		
住所	〒391-0013 茅野市宮川1386-6		
電話/FAX	0266-72-1565/0266-72-8659	E-mail	r-kitahara@yahata-seiko.co.jp
資本金(百万円)	18	設立年月日	昭和45年9月
		売上(百万円)	—
		従業員数	21

特記事項 ①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他